

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT6403107

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
TAKASHI TOJIMA	05/21/2019
YASUSHI NEMOTO	11/12/2020
TSUTOMU MORITA	05/17/2019
ATSUSHI OCHIYA	11/10/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	KYOCERA CORPORATION
Street Address:	6, TAKEDA TOBADONO-CHO
Internal Address:	FUSHIMI-KU
City:	KYOTO-SHI, KYOTO
State/Country:	JAPAN
Postal Code:	612-8501
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	17055699
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(215)568-6499
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	2155686400
Email:	lgivigliano@vklaw.com
Correspondent Name:	VOLPE KOENIG
Address Line 1:	30 SOUTH 17TH STREET, 18TH FLOOR
Address Line 4:	PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19103
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	KIPKYO-PT008
NAME OF SUBMITTER:	GERALD B. HALT, JR.
SIGNATURE:	/Gerald B. Halt, Jr./
DATE SIGNED:	11/16/2020
Total Attachments: 12	
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page1.tif	

source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page2.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page3.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page4.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page5.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page6.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page7.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page8.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page9.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page10.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page11.tif
source=KIPKYO_PT008_AssignmentDeclaration_EFS#page12.tif

COMBINED ASSIGNMENT AND DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION
一般又は意匠特許出願用の宣言書 (37 CFR 1.63) 付き譲渡書

Title of Invention 発明の名称	POWER SEMICONDUCTOR MODULE パワー半導体モジュール	
<p>下記発明者である私は、次のことがらを宣誓します：</p> <p>本宣言書付き譲渡書は、</p> <p><input type="checkbox"/> 添付されている出願、あるいは</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2019年5月16日に提出された 米国出願番号またはPCT国際出願番号PCT/JP2019/019564に宛てられて います。</p> <p>上記の出願は私自身、あるいは私が権限を授与したものによって行 われたものです。</p> <p>私は本出願中の請求項に係る発明のもともとの発明者、あるいはも ともとの共同発明者であると信じております。</p> <p>本宣言書において故意に虚偽の申し立てを行った場合は18 U.S.C. 1001により、罰金あるいは最高五（5）年の禁固刑、あるいはその 両方による罰則の対象となることを認めます。</p> <p>下記署名者に対して支払われる有効かつ価値ある対価に基づき、下 記署名者は、譲受人、</p> <p>京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501、日本国 京セラ株式会社 （上記を、以下譲受人）</p> <p>へ、下記署名者が特許の出願に署名した、パワー半導体モジュールの 名称で知られ、2019年5月16日に、米国特許出願番号またはPCT 国際出願番号PCT/JP2019/019564として提出された発明の、全世界に おけるすべての権利、権限、及び利益を、ここに譲渡し、移転し、 引き渡します。この譲渡は、上記出願、そして、上記発明もしくは その改良に対して付与された、ありとあらゆる米国及び外国での特 許、実用新案、意匠登録を含み、さらに、工業財産保護に関する国 際条約、特許協力条約、欧州特許条約、その他の類似の目的をもっ たすべての条約に基づき、上記出願の出願日を基礎として優先権を 主張する権利を含みます。</p>		<p>As the below named inventor, I hereby declare that:</p> <p>This combined declaration and assignment is directed to:</p> <p><input type="checkbox"/> The attached application, or</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> United States application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 filed on May 16, 2019.</p> <p>The above-identified application was made or authorized to be made by me.</p> <p>I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.</p> <p>I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.</p> <p>In consideration of the good and valuable considerations paid to the undersigned, the undersigned does hereby assign, transfer and set over to KYOCERA Corporation of 6 Takeda Tobadono- cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 612-8501 (hereinafter designated as the Assignee), the entire worldwide right, title and interest in the invention known as <u>POWER SEMICONDUCTOR MODULE</u></p> <hr/> <p>which was filed as US Patent Application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 on May 16, 2019 for which the undersigned has executed an application for patent; this assignment including said application, any and all United States and foreign patents, utility models, and design registrations granted for any of said inventions or improvements, and the right to claim priority based on the filing date of said application under the International Convention of the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty, the European Patent Convention, and all other treaties of like purposes.</p>

Attorney Docket No. _____
弁護士管理番号

下記署名者は、上記の発明に関し米国及び外国に於ける原出願、再発行、分割及び継続出願に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意します。下記署名者は、また、譲受人が必要もしくは便宜と看做した際には、かかる出願に関し別個の譲渡手続きを行うことに同意します。

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any original, reissue, divisional and continuing United States and foreign applications for the above identified invention and also to execute separate assignments in connection with such applications as the Assignee may deem necessary or expedient.

下記署名者は、当該出願又はその継続出願又は分割出願に関し提起され得る抵触審査に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意する。さらに、かかる抵触審査を進展させ、証拠の入手するにあたり、譲受人に対しあらゆる協力をすることに同意する。

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any interference which may be declared concerning this application or continuation or division thereof and to cooperate with the Assignee in every way possible in obtaining evidence and going forward with such interference.

下記署名者は、工業財産保護に関する国際条約もしくは類似の合意における条項又は要求に関連し、全ての文書及び書面を作成し、必要とされ得るいかなる行為を行うことに同意します。

The undersigned agrees to execute all papers and documents and perform any act which may be necessary in connection with claims or provisions of the International Convention for Protection of Industrial Property or similar agreements.

下記署名者は、譲受人が有効な米国特許の付与を獲得するため必要とされ得るあらゆる積極的な行為を行うことに同意します。

The undersigned agrees to perform all affirmative acts which may be necessary to obtain a grant of a valid United States patent to the Assignee.

下記署名者は、ここに、特許庁長官に対し、当該出願又はそのいずれの分割もしくは継続する出願から生じたすべての米国特許証を、全利益の譲受人として、上記譲受人に発行する権限を与え、且つ、かかる発行を要請します。さらに、下記署名者は、ここに譲渡される全利益を譲渡する権利を有すること、また、当該内容に矛盾するいかなる契約も締結していないことをここに誓約します。

The undersigned hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents to issue any and all Letters Patents of the United States resulting from said application or any division or divisions or continuing applications thereof to the said Assignee, as Assignee of the entire interest, and hereby covenants that he has full right to convey the entire interest here in assigned and that he has not executed any agreement in conflict herewith.

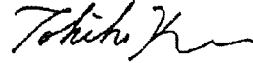
下記署名者は、米国特許商標局の本文書を記録することに関する規則に従うため、必要または望ましいとされる識別を本譲渡証にさらに挿入する権限を、譲受人及び上記出願に於いて任命された譲受人の代理人に与えます。

The undersigned hereby grants to the Assignee and its attorneys appointed in said application the power to insert on this assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

Attorney Docket No. _____
弁護士管理番号STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE
WITH 37 CFR 1.69(b):

The Combined Assignment And Declaration (37 CFR 1.63) For Utility
Or Design Application is an accurate translation of the corresponding
English language Combined Assignment And Declaration (37 CFR
1.63) For Utility Or Design Application.

Signature:



Date:

03-31-2017

LEGAL NAME OF INVENTOR/発明者の正式氏名

inventor/発明者: Takashi TOJIMA

Date /日付: 2019/05/21

Signature/署名:

Takashi TOJIMA

COMBINED ASSIGNMENT AND DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION
一般又は意匠特許出願用の宣言書 (37 CFR 1.63) 付き譲渡書

Title of Invention 発明の名称	POWER SEMICONDUCTOR MODULE パワー半導体モジュール
<p>下記発明者である私は、次のことがらを宣誓します:</p> <p>本宣言書付き譲渡書は、</p> <p><input type="checkbox"/> 添付されている出願、あるいは</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2019年5月16日に提出された</p> <p>米国出願番号またはPCT国際出願番号PCT/JP2019/019564に宛てられています。</p> <p>上記の出願は私自身、あるいは私が権限を授与したものによって行われたものです。</p> <p>私は本出願中の請求項に係る発明のもともとの発明者、あるいはもともとの共同発明者であると信じております。</p> <p>本宣誓書において故意に虚偽の申し立てを行った場合は18 U.S.C. 1001により、罰金あるいは最高五（5）年の禁固刑、あるいはその両方による罰則の対象となることを認めます。</p> <p>下記署名者に対して支払われる有効かつ価値ある対価に基づき、下記署名者は、譲受人、</p> <p>京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地</p> <p>〒612-8501、日本国</p> <p>京セラ株式会社</p> <p>(上記を、以下譲受人)</p> <p>へ、下記署名者が特許の出願に署名した、パワー半導体モジュールの名称で知られ、2019年5月16日に、米国特許出願番号またはPCT国際出願番号PCT/JP2019/019564として提出された発明の、全世界におけるすべての権利、権限、及び利益を、ここに譲渡し、移転し、引き渡します。この譲渡は、上記出願、そして、上記発明もしくはその改良に対して付与された、ありとあらゆる米国及び外国での特許、実用新案、意匠登録を含み、さらに、工業財産保護に関する国際条約、特許協力条約、欧州特許条約、その他の類似の目的をもったすべての条約に基づき、上記出願の出願日を基礎として優先権を主張する権利を含みます。</p>	<p>As the below named inventor, I hereby declare that:</p> <p>This combined declaration and assignment is directed to:</p> <p><input type="checkbox"/> The attached application, or</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> United States application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 filed on May 16, 2019.</p> <p>The above-identified application was made or authorized to be made by me.</p> <p>I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.</p> <p>I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.</p> <p>In consideration of the good and valuable considerations paid to the undersigned, the undersigned does hereby assign, transfer and set over to KYOCERA Corporation of 6 Takeda Tobadonocho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 612-8501 (hereinafter designated as the Assignee), the entire worldwide right, title and interest in the invention known as <u>POWER SEMICONDUCTOR MODULE</u></p> <p>which was filed as US Patent Application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 on May 16, 2019</p> <p>for which the undersigned has executed an application for patent; this assignment including said application, any and all United States and foreign patents, utility models, and design registrations granted for any of said inventions or improvements, and the right to claim priority based on the filing date of said application under the International Convention of the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty, the European Patent Convention, and all other treaties of like purposes.</p>

下記署名者は、上記の発明に関し米国及び外国に於ける原出願、再発行、分割及び継続出願に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意します。下記署名者は、また、譲受人が必要もしくは便宜と看做した際には、かかる出願に関し別個の譲渡手続きを行うことに同意します。

下記署名者は、当該出願又はその継続出願又は分割出願に関し提起され得る抵触審査に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意する。さらに、かかる抵触審査を進展させ、証拠の入手するにあたり、譲受人に対しあらゆる協力をすることに同意する。

下記署名者は、工業財産保護に関する国際条約もしくは類似の合意における条項又は要求に関連し、全ての文書及び書面を作成し、必要とされ得るいかなる行為を行うことに同意します。

下記署名者は、譲受人が有効な米国特許の付与を獲得するため必要とされ得るあらゆる積極的な行為を行うことに同意します。

下記署名者は、ここに、特許庁長官に対し、当該出願又はそのいずれの分割もしくは継続する出願から生じたすべての米国特許証を、全利益の譲受人として、上記譲受人に発行する権限を与え、且つ、かかる発行を要請します。さらに、下記署名者は、ここに譲渡される全利益を譲渡する権利を有すること、また、当該内容に矛盾するいかなる契約も締結していないことをここに誓約します。

下記署名者は、米国特許商標局の本文書を記録することに関する規則に従うため、必要または望ましいとされる識別を本譲渡証にさらに挿入する権限を、譲受人及び上記出願に於いて任命された譲受人の代理人に与えます。

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any original, reissue, divisional and continuing United States and foreign applications for the above identified invention and also to execute separate assignments in connection with such applications as the Assignee may deem necessary or expedient.

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any interference which may be declared concerning this application or continuation or division thereof and to cooperate with the Assignee in every way possible in obtaining evidence and going forward with such interference.

The undersigned agrees to execute all papers and documents and perform any act which may be necessary in connection with claims or provisions of the International Convention for Protection of Industrial Property or similar agreements.

The undersigned agrees to perform all affirmative acts which may be necessary to obtain a grant of a valid United States patent to the Assignee.

The undersigned hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents to issue any and all Letters Patents of the United States resulting from said application or any division or divisions or continuing applications thereof to the said Assignee, as Assignee of the entire interest, and hereby covenants that he has full right to convey the entire interest here in assigned and that he has not executed any agreement in conflict herewith.

The undersigned hereby grants to the Assignee and its attorneys appointed in said application the power to insert on this assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

**STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE
WITH 37 CFR 1.69(b):**

The Combined Assignment And Declaration (37 CFR 1.63) For Utility
Or Design Application is an accurate translation of the corresponding
English language Combined Assignment And Declaration (37 CFR
1.63) For Utility Or Design Application.

Signature:

Date: 03-31-2017**LEGAL NAME OF INVENTOR/発明者の正式氏名**

Inventor/発明者: YASUSHI NEMOTO

Date /日付: 2020/11/12

Signature/署名:



COMBINED ASSIGNMENT AND DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION
一般又は意匠特許出願用の宣言書 (37 CFR 1.63) 付き譲渡書

Title of Invention 発明の名称	POWER SEMICONDUCTOR MODULE パワー半導体モジュール	
<p>下記発明者である私は、次のことがらを宣誓します：</p> <p>本宣言書付き譲渡書は、</p> <p><input type="checkbox"/> 添付されている出願、あるいは</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2019年5月16日出願された 米国出願番号またはPCT国際出願番号PCT/JP2019/019564に宛てられて います。</p> <p>上記の出願は私自身、あるいは私が権限を授与したものによって行 われたものです。</p> <p>私は本出願中の請求項に係る発明のもともとの発明者、あるいはも ともとの共同発明者であると信じております。</p> <p>本宣言書において故意に虚偽の申し立てを行った場合は18 U.S.C. 1001により、罰金あるいは最高五（5）年の禁固刑、あるいはその 両方による罰則の対象となることを認めます。</p> <p>下記署名者に対して支払われる有効かつ価値ある対価に基づき、下 記署名者は、譲受人、</p> <p>京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501、日本国 京セラ株式会社 （上記を、以下譲受人）</p> <p>へ、下記署名者が特許の出願に署名した、パワー半導体モジュールの 名称で知られ、2019年5月16日に、米国特許出願番号またはPCT 国際出願番号PCT/JP2019/019564として出願された発明の、全世界に おけるすべての権利、権限、及び利益を、ここに譲渡し、移転し、 引き渡します。この譲渡は、上記出願、そして、上記発明もしくは その改良に対して付与された、ありとあらゆる米国及び外国での特 許、実用新案、意匠登録を含み、さらに、工業財産保護に関する国 際条約、特許協力条約、欧州特許条約、その他の類似の目的をもっ たすべての条約に基づき、上記出願の出願日を基礎として優先権を 主張する権利を含みます。</p>		<p>As the below named inventor, I hereby declare that:</p> <p>This combined declaration and assignment is directed to:</p> <p><input type="checkbox"/> The attached application, or</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> United States application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 filed on May 16, 2019.</p> <p>The above-identified application was made or authorized to be made by me.</p> <p>I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.</p> <p>I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.</p> <p>In consideration of the good and valuable considerations paid to the undersigned, the undersigned does hereby assign, transfer and set over to KYOCERA Corporation of 6 Takeda Tobadono- cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 612-8501 (hereinafter designated as the Assignee), the entire worldwide right, title and interest in the invention known as</p> <p><u>POWER SEMICONDUCTOR MODULE</u></p> <p>which was filed as US Patent Application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 on May 16, 2019</p> <p>for which the undersigned has executed an application for patent; this assignment including said application, any and all United States and foreign patents, utility models, and design registrations granted for any of said inventions or improvements, and the right to claim priority based on the filing date of said application under the International Convention of the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty, the European Patent Convention, and all other treaties of like purposes.</p>

Attorney Docket No. _____
弁護士管理番号

下記署名者は、上記の発明に関し米国及び外国に於ける原出願、再発行、分割及び継続出願に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意します。下記署名者は、また、譲受人が必要もしくは便宜と看做した際には、かかる出願に関し別個の譲渡手続きを行うことに同意します。

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any original, reissue, divisional and continuing United States and foreign applications for the above identified invention and also to execute separate assignments in connection with such applications as the Assignee may deem necessary or expedient.

下記署名者は、当該出願又はその継続出願又は分割出願に関し提起され得る抵触審査に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意する。さらに、かかる抵触審査を進展させ、証拠の入手するにあたり、譲受人に対しあらゆる協力をすることに同意する。

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any interference which may be declared concerning this application or continuation or division thereof and to cooperate with the Assignee in every way possible in obtaining evidence and going forward with such interference.

下記署名者は、工業財産保護に関する国際条約もしくは類似の合意における条項又は要求に関連し、全ての文書及び書面を作成し、必要とされ得るいかなる行為を行うことに同意します。

The undersigned agrees to execute all papers and documents and perform any act which may be necessary in connection with claims or provisions of the International Convention for Protection of Industrial Property or similar agreements.

下記署名者は、譲受人が有効な米国特許の付与を獲得するため必要とされ得るあらゆる積極的な行為を行うことに同意します。

The undersigned agrees to perform all affirmative acts which may be necessary to obtain a grant of a valid United States patent to the Assignee.

下記署名者は、ここに、特許庁長官に対し、当該出願又はそのいずれの分割もしくは継続する出願から生じたすべての米国特許証を、全利益の譲受人として、上記譲受人に発行する権限を与え、且つ、かかる発行を要請します。さらに、下記署名者は、ここに譲渡される全利益を譲渡する権利を有すること、また、当該内容に矛盾するいかなる契約も締結していないことをここに誓約します。

The undersigned hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents to issue any and all Letters Patents of the United States resulting from said application or any division or divisions or continuing applications thereof to the said Assignee, as Assignee of the entire interest, and hereby covenants that he has full right to convey the entire interest here in assigned and that he has not executed any agreement in conflict herewith.

下記署名者は、米国特許商標局の本文書を記録することに関する規則に従うため、必要または望ましいとされる識別を本譲渡証にさらに挿入する権限を、譲受人及び上記出願に於いて任命された譲受人の代理人に与えます。

The undersigned hereby grants to the Assignee and its attorneys appointed in said application the power to insert on this assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

Attorney Docket No. _____
弁護士管理番号

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE
WITH 37 CFR 1.69(b):

The Combined Assignment And Declaration (37 CFR 1.63) For Utility
Or Design Application is an accurate translation of the corresponding
English language Combined Assignment And Declaration (37 CFR
1.63) For Utility Or Design Application.

Signature:



Date:

03-31-2017

LEGAL NAME OF INVENTOR/発明者の正式氏名

Inventor/発明者: Tsutomu MORITA

Date /日付:

2019/5/17

Signature/署名:



COMBINED ASSIGNMENT AND DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION
一般又は意匠特許出願用の宣言書 (37 CFR 1.63) 付き譲渡書

Title of Invention 発明の名称	POWER SEMICONDUCTOR MODULE パワー半導体モジュール
<p>下記発明者である私は、次のことがらを宣誓します：</p> <p>本宣言書付き譲渡書は、</p> <p><input type="checkbox"/> 添付されている出願、あるいは</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 2019年5月16日に提出された</p> <p>米国出願番号またはPCT国際出願番号PCT/JP2019/019564に宛てられています。</p> <p>上記の出願は私自身、あるいは私が権限を授与したものによって行われたものです。</p> <p>私は本出願中の請求項に係る発明のもともとの発明者、あるいはもともとの共同発明者であると信じております。</p> <p>本宣誓書において故意に虚偽の申し立てを行った場合は18 U.S.C. 1001により、罰金あるいは最高五（５）年の禁固刑、あるいはその両方による罰則の対象となることを認めます。</p> <p>下記署名者に対して支払われる有効かつ価値ある対価に基づき、下記署名者は、譲受人、</p> <p>京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地</p> <p>〒612-8501、日本国</p> <p>京セラ株式会社</p> <p>（上記を、以下譲受人）</p> <p>へ、下記署名者が特許の出願に署名した、パワー半導体モジュールの名称で知られ、2019年5月16日に、米国特許出願番号またはPCT国際出願番号PCT/JP2019/019564として提出された発明の、全世界におけるすべての権利、権限、及び利益を、ここに譲渡し、移転し、引き渡します。この譲渡は、上記出願、そして、上記発明もしくはその改良に対して付与された、ありとあらゆる米国及び外国での特許、実用新案、意匠登録を含み、さらに、工業財産保護に関する国際条約、特許協力条約、欧州特許条約、その他の類似の目的をもったすべての条約に基づき、上記出願の出願日を基礎として優先権を主張する権利を含みます。</p>	<p>As the below named inventor, I hereby declare that:</p> <p>This combined declaration and assignment is directed to:</p> <p><input type="checkbox"/> The attached application, or</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> United States application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 filed on May 16, 2019.</p> <p>The above-identified application was made or authorized to be made by me.</p> <p>I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.</p> <p>I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.</p> <p>In consideration of the good and valuable considerations paid to the undersigned, the undersigned does hereby assign, transfer and set over to KYOCERA Corporation of 6 Takeda Tobadonocho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 612-8501 (hereinafter designated as the Assignee), the entire worldwide right, title and interest in the invention known as</p> <p><u>POWER SEMICONDUCTOR MODULE</u></p> <p>which was filed as US Patent Application or PCT international application number PCT/JP2019/019564 on May 16, 2019</p> <p>for which the undersigned has executed an application for patent; this assignment including said application, any and all United States and foreign patents, utility models, and design registrations granted for any of said inventions or improvements, and the right to claim priority based on the filing date of said application under the International Convention of the Protection of Industrial Property, the Patent Cooperation Treaty, the European Patent Convention, and all other treaties of like purposes.</p>

下記署名者は、上記の発明に関し米国及び外国に於ける原出願、再発行、分割及び継続出願に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意します。下記署名者は、また、譲受人が必要もしくは便宜と看做した際には、かかる出願に関し別個の譲渡手続きを行うことに同意します。

下記署名者は、当該出願又はその継続出願又は分割出願に関し提起され得る抵触審査に関連して必要な全ての書類手続きを遂行することに同意する。さらに、かかる抵触審査を進展させ、証拠の入手するにあたり、譲受人に対しあらゆる協力をすることに同意する。

下記署名者は、工業財産保護に関する国際条約もしくは類似の合意における条項又は要求に関連し、全ての文書及び書面を作成し、必要とされ得るいかなる行為を行うことに同意します。

下記署名者は、譲受人が有効な米国特許の付与を獲得するため必要とされ得るあらゆる積極的な行為を行うことに同意します。

下記署名者は、ここに、特許庁長官に対し、当該出願又はそのいずれの分割もしくは継続する出願から生じたすべての米国特許証を、全利益の譲受人として、上記譲受人に発行する権限を与え、且つ、かかる発行を要請します。さらに、下記署名者は、ここに譲渡される全利益を譲渡する権利を有すること、また、当該内容に矛盾するいかなる契約も締結していないことをここに誓約します。

下記署名者は、米国特許商標局の本文書を記録することに関する規則に従うため、必要または望ましいとされる識別を本譲渡証にさらに挿入する権限を、譲受人及び上記出願に於いて任命された譲受人の代理人に与えます。

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any original, reissue, divisional and continuing United States and foreign applications for the above identified invention and also to execute separate assignments in connection with such applications as the Assignee may deem necessary or expedient.

The undersigned agrees to execute all papers necessary in connection with any interference which may be declared concerning this application or continuation or division thereof and to cooperate with the Assignee in every way possible in obtaining evidence and going forward with such interference.

The undersigned agrees to execute all papers and documents and perform any act which may be necessary in connection with claims or provisions of the International Convention for Protection of Industrial Property or similar agreements.

The undersigned agrees to perform all affirmative acts which may be necessary to obtain a grant of a valid United States patent to the Assignee.

The undersigned hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents to issue any and all Letters Patents of the United States resulting from said application or any division or divisions or continuing applications thereof to the said Assignee, as Assignee of the entire interest, and hereby covenants that he has full right to convey the entire interest here in assigned and that he has not executed any agreement in conflict herewith.

The undersigned hereby grants to the Assignee and its attorneys appointed in said application the power to insert on this assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

Attorney Docket No. _____
弁護士管理番号STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE
WITH 37 CFR 1.69(b):

The Combined Assignment And Declaration (37 CFR 1.63) For Utility
Or Design Application is an accurate translation of the corresponding
English language Combined Assignment And Declaration (37 CFR
1.63) For Utility Or Design Application.

Signature:



Date:

03-31-2017

LEGAL NAME OF INVENTOR/発明者の正式氏名

Inventor/発明者: ATSUSHI OCHIYA

Date /日付: 2020/11/10

Signature/署名:

